

迅得機械「智慧製造科技論文獎」競賽辦法

一、緣起與設立宗旨

為響應政府積極推動智慧機械與智慧製造產業，促進國家產業轉型升級，以達成亞洲高階製造中心的願景。並鼓勵國內大專院校學生投入智慧製造系統解決方案之研發與創新，為產業培養優秀的機電整合、軟體設計、AI應用的跨領域人才，並增進產學合作的融合，進而促進智慧製造智動化產業技術與競爭力的提升。

二、競賽主題

智慧機械、智動化工程、人工智慧、感知技術、精密工程、數據分析、智慧製造、自動化搬運系統、智慧機械人應用等領域相關研究。

三、參賽對象與條件(詳細競賽辦法，請參閱附檔說明)

- 台灣各大專院校機械、電機(子)、資工、工工(管)、自動化工程等相關系所在學或應屆畢業生與指導教授。
- 進入決賽者需提供簡報及海報電子檔。
- 參賽隊伍或個人所提供與填報之各項資料內容，均屬(1)真實無侵害他人權益(2)原創，並未抄襲他人或代筆之情形。
- 參與競賽論文依「中國機械工程學會」之論文格式為準，以長摘要方式撰寫3頁以內為原則，簡明扼要呈現競賽主題相關之在學研究成果。

四、時程與地點

- 初賽徵件日期：即日起至2022年8月20日止
- 公布入圍決賽名單：2022年9月20日(正取10隊，備取5隊)
- 決賽簡報與海報電子檔上傳日期：2022年9月30日前
- 決賽日期：2022年10月15日(六) 09:00~16:00
- 決賽地點：元智大學機械系 3201
- 請依通知之順序於報到時間30分鐘前辦理報到手續，決賽成績當場宣布並頒發得獎證書
- 頒獎典禮與成果發表日期：2022年10月26日
- 頒獎典禮與成果發表地點：南港展覽場TPCA Show 迅得展示區
- 各階段入圍名單將公布於活動網站上，並以電子郵件通知入圍隊伍及得獎名單。

五、評比方式與評分標準

初賽：由主辦單位邀請產官學界專家學者組成評審委員會，依評分標準對參賽之論文內容進行評選作業。選出正取10隊進入決賽階段。備取5隊，如正取放棄則依序替補。

初賽評分標準：學術價值應用性：50% / 創新價值性：50%

決賽：以口頭發表方式實施，須由參賽學生代表進行18分鐘簡報，5分鐘Q & A。由評審委員依評分標準，評選出：金質獎1名、銀質獎2名、銅質獎3名及佳作4名。

決賽評分標準：完整性：30% / 商業價值：30% / 創新性：30% / 簡報技巧：10%

六、獎金及獎額

獎項	名額	獎額	獎項內容
金質獎	1	10萬	得獎者頒發獎狀、獎牌及獎金10萬元獎金分配原則以指導老師50%，學生50%
銀質獎	2	6萬	得獎者頒發獎狀、獎牌及獎金6萬元獎金分配原則以指導老師50%，學生50%
銅質獎	3	3萬	得獎者頒發獎狀、獎牌及獎金3萬元獎金分配原則以指導老師50%，學生50%
佳作獎	4	1萬	得獎者頒發獎狀、獎牌及獎金1萬元獎金分配原則以指導老師50%，學生50%

總獎金：新台幣35萬元

七、成果發表與頒獎活動

- 主辦單位將於2022年10月26日 TPCA 國際展覽會舉行頒獎典禮，邀請所有得獎教授與學生代表參與盛會，接受表揚並領取獎金與獎牌。
- 贊助得獎者(可指派代表)於電路板產業國際展覽會期間，於迅得展示區提供影音展示台進行成果發表。

八、辦理單位

主辦單位：迅得機械股份有限公司

協辦單位：TPCA 台灣電路板協會、國立中央大學、中原大學、健行科技大學

承辦單位：元智大學

九、收件與聯絡窗口

上傳郵件地址與聯絡人：

鄭曉菁 E-mail: May.Cheng@saa-symtek.com / Tel: 03-4356870 #369

公司地址：320040 桃園市中壢區榮民路421號

公司官網：www.saa-symtek.com



迅得機械股份有限公司
Symtek Automation Asia